

半導体をもっと小型に、高機能に。新日鉄の最先端技術がお応えします。

ICチップと基板を直接面接続し、より小さなスペースで、大容量・高速の情報処理を可能にするマイクロボール。携帯電話やデジカメなど、モバイルの小型化、高機能化、耐落下衝撃性などを高める決め手となる新素材です。新日鉄では、直径100ミクロン以下の超精密なマイクロボールをも、ウエーハ上に均一に一括搭載する「マイクロボール・バンピング」サービスを世界に先駆けてスタート。ボール製造から搭載まで、お客さまニーズにマッチしたトータルソリューションをご提供しています。材料技術、解析技術を知りつくしているからこそ、新素材をより小さく、より高度に進化させることができる。新日鉄、最先端のテクノロジーも、ぜひお見逃しなく。

お問い合わせは新素材事業部 Tel.03-3275-6154

モバイル進化の決め球です  
新日鉄のマイクロボール。



<http://www.nsc.co.jp>